

证券代码：605358

证券简称：立昂微

## 杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年5月7日 14:30-15:30 中信证券、国寿养老 2026年5月7日 16:30-17:30 华宝基金 2026年5月8日 11:30-12:30 中信证券、博时基金 2026年5月12日 15:00-16:30 国金证券、华福证券、财通证券、东方财富证券、诺安基金、嘉实基金、新华基金、平安基金、民生加银、泓得基金、华能贵诚信托、健顺投资、杭银理财、礼正、沃金、旦恩、固禾基金、中哲物产、上海信托等 2026年5月13日 11:15-12:00 国信证券、兴全基金 2026年5月13日 15:30-17:20 广发证券、国投瑞银、新华资产、华商基金、大成基金、姚泾河基金等 2026年5月14日 11:15-12:15 中信证券、广发基金 2026年5月14日 15:30-17:20 广发证券、博时基金、华夏基金、中欧基金、南方基金、建信基金、摩根资产、鹏华基金
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>董事长王敏文、董事会秘书吴能云就公司2025年年度及2026年第一季度的经营情况作了介绍，并就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。</p> <p>公司投资者交流的主要问题回复内容如下：</p> <p>1.公司重掺硅片技术领先，其他竞争者是否也会进入？优势是否能维持？</p> <p>答：轻掺与重掺属于完全独立的两条技术路线，需要分别配置专属研发生产团队、专用设备体系，下游客户结构也存在明显区分。重掺领域具备较强的技术壁垒，需要搭建专业团队，从事轻掺业务的人员无法直接适配重掺技术体系，两条路线不能简单互通，更需要长期持续的工艺沉淀与技术积累。与此同时，公司目前在相关领域已具备行业领先的技术实力。想要持续巩固并扩大领先优势，就必须坚持研发投入，持续迭代、开发适配客户需求的新产品，这也是公司长期聚焦、重点突破的核心方向。</p>

2.公司重掺 12 英寸硅片订单情况如何？

答：公司 12 英寸重掺硅片订单饱满，其中低电阻率重掺硅片因产能饱满已出现交货延期。

3.公司轻掺硅片发展策略如何考虑？

答：公司 12 英寸轻掺硅片产品线坚持高端化、差异化发展路线，充分发挥深厚的外延工艺技术积淀，区别于传统轻掺硅片过度集中于特定应用领域的市场格局，以差异化的技术路径和卓越的定制化产品性能，避开同质化竞争。公司逻辑电路用轻掺硼外延片，BCD 工艺、PMIC 电源用轻掺硼硅片等相较于常规轻掺硅片具有更高议价能力，目前已在客户端快速上量，28nm 逻辑电路用轻掺外延片已批量出货，未来将重点推进 12 英寸轻掺产品产能爬坡与更先进制程突破。

4.公司 VCSEL 芯片预计会有多大增长？

答：立昂东芯 VCSEL 芯片技术居全球第一梯队，二维可寻址大功率 VCSEL 工艺技术已深度赋能车载激光雷达、智能视觉传感领域，已实现规模出货，预计 2026 年出货量会有进一步的快速增长。

5.公司未来计划新增投资吗？

答：公司主要推进现有已建成项目的产能爬坡，目前在建的项目主要包括：投资 22.62 亿元的年产 180 万片 12 英寸重掺衬底硅片项目、投资 23.02 亿元的年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目以及投资 12.30 亿元的年产 96 万片 12 英寸轻掺硅外延片项目，这些项目正在有序推进中，现阶段公司暂无新增大规模投资的规划。

6. 公司可转债是否会强赎？

答：目前可转债赎回条件尚未满足，如果满足赎回条件，将提交董事会讨论决策，并及时履行信息披露义务。